

Vitronics Soltec

Electronic Assembly Equipment

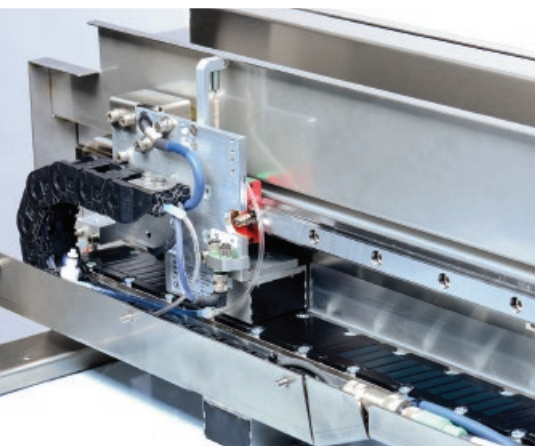
TW EAE

ZEVA 选择性焊接解决方案

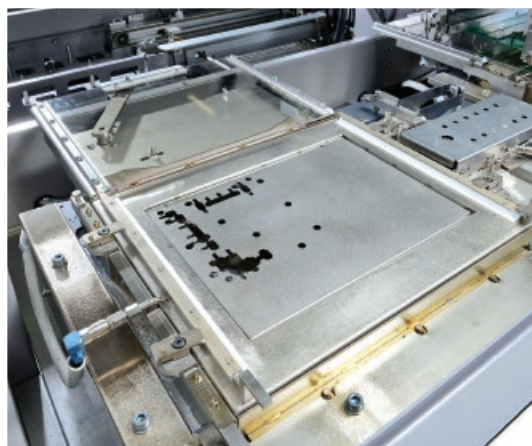


百年焊接技术
成就被经过验证的性能

- 高频助焊剂喷涂技术提供最精准的制程, 应对最高质量挑战
- 专利的对流预热技术提供最佳传热, 解决最复杂的热性能要求
- 专利的焊接设计, 出色应对小型化挑战
- 平台灵活, 用户定制化程度高, 并且允许在运行时转换
- 制程控制可最大程度掌握日常设备工作性能



高频高速助焊剂滴状喷射, 符合每次循环时间和点滴大小要求



可持续性的设计, 优化的氮气环境, 在增加生产良率的同时保持更低运行成本



可撤离式锡槽能在生产中实现产品转换, 提高工效



选择性焊接解决方案

ZEVAv 将选择性焊接技术提升到一个新的层面。这正是今天你需要的，满足日益增长的高产量、低成本高效率生产和制程控制需求。ZEVAv 可以在生产过程中同时执行操作和维护，机器结构能够适应恰当的配置，以匹配每种应用。

主要标配特性

- 高频助焊剂喷涂
- 在线预热
- 智能示教离线编程 (SmartTeach)
- 自动宽度调整
- SMEMA 接口
- 先进的焊料添加系统
- .net 软件

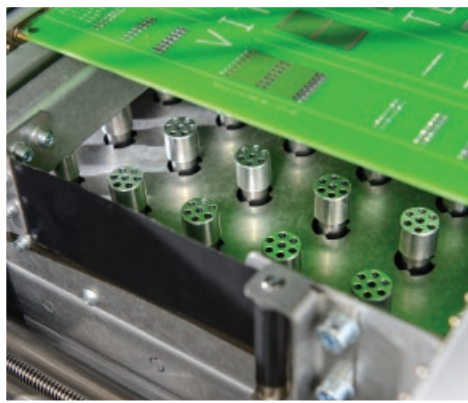
主要选项特性

- 闭环式预热器管理
- PCB 板翘曲度自动补偿系统
- 多达三个预热区
- 多达三个多喷嘴或选择波峰焊接站
- 基板同侧进出
- 助焊剂流量监控
- 顶部对流加热
- 双轴向助焊剂喷嘴机械配置

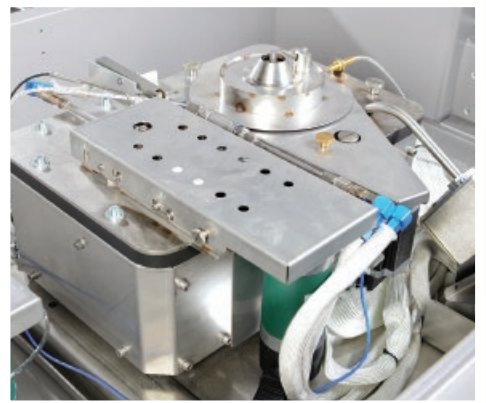
型号	ZEVAv
最大 PCB 或托盘尺寸	310 x 410 mm
最大 PCB 承重	10 kg
锡槽容量	MW 180 kg / SW 45 kg
最大焊接区域	250 x 350 mm
耗氮量	75 L/分钟
正面最大元器件高度	120 mm
电源要求	3 x 400V 50/60 Hz
设备尺寸 (L x W x H) (去除灯塔)	3080 x 1675 x 1620 mm



无需中断生产即可添加助焊剂和焊料



多达 5 个预热区, 最佳对流预热性能



独特的旋转式非润湿型焊接喷嘴

ITW EAE 是依工集团 (Illinois Tool Works, Inc) 下的一个分支部门, 其整合所有电子组装设备和热处理技术, 该部门包括 MPM、Camalot、Electrovert、Vitronics Soltec 和 Despatch 等世界级产品。

Vitronics Soltec

Soldering Solutions

ITW EAE